**泰凌微电子（上海）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

**证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2024-013**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动**  **类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  √现场参观 □其他 |
| **参与单位名称**  **及人员姓名** | 广发基金 费逸  红土创新基金 李传鹏  天风证券 骆奕扬  个人投资者 郭畑  亿廷家办 孙文通  傲洋投资 徐德红  华云控股 颜晓滨  个人投资者 叶峰  新生基金 江泽宏  中信信托 禹丽琦  和君咨询 何其俊  龙全投资 王振鹏  云端草堂 牛玉雯  德胜皓威 彭车泥  卢湾天益 王振华  加特兰电子 杜磊  陶山私募 李长庚 |
| **时间** | 2024年11月11日 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员**  **姓名** | 董事、总经理：盛文军  副总经理、董事会秘书：李鹏  证券事务代表：马军 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 一、公司董事、总经理盛文军主持投资者交流并回复相关提问；公司副总经理、董事会秘书李鹏先生介绍公司的基本情况、股权结构及实际控制人简介、核心技术人员概况、公司的产品和行业情况、核心技术优势、下游应用领域、未来发展方向、简要财务数据。  二、交流环节：  Q1：公司的芯片产品和下游应用领域？  A1：公司目前主要产品为IoT芯片以及音频芯片，其中IoT芯片以低功耗蓝牙类SoC产品为主，同时还有2.4G私有协议类SoC产品、兼容多种物联网应用协议的多模类SoC产品、ZigBee协议类SoC产品。  公司产品下游应用领域和产品形态丰富，下游客户较为分散，公司收入主要来自于智能遥控器、电脑周边、智能家居和照明、智能电子价签等下游细分应用领域。  Q2：IPO募投项目“发展与科技储备项目”的安排情况？  A2：“发展与科技储备项目”中项目规划是“基于先进制程的工艺导入项目”及“IoT边缘处理芯片架构以及产品研发项目”，两项目的投资时间计划为2025~2028年。公司将结合现有业务情况，以目前产品为基础，面向未来，导入先进制程的工艺以及运用公司IoT芯片领域的技术储备在极低功耗的情况下拓展边缘处理芯片的产品研发，围绕既定的业务发展目标，积极有序投入发展与科技储备项目，进一步提升公司在相关领域的技术突破和创新。  Q3：公司是否有并购计划？  A3：公司会以主营业务为中心，寻求合适的外延发展机会，扩大公司规模，提高公司综合竞争力，充分发挥上市公司的平台作用。  Q4：公司芯片流片在哪里？  A4：目前流片主要是在中芯国际和台积电。  Q5：海外业务在哪些国家地区？主要是哪些产品？  A5：公司海外业务布局主要是欧洲和美国，目前主要是低功耗蓝牙和Zigbee产品。  Q6：公司海外业务是否存在被限制的风险？  A6：公司目前的产品主要还是55纳米和22纳米的，是非常成熟的工艺了。目前来看，海外还是针对先进制程进行限制，对成熟制程的限制还没有。所以公司产品在海外被限制的可能性比较低。  Q7：今年三季度业绩增长比较好的原因?  A7：公司三季度业绩增长主要系公司积极开拓境内外市场、加大客户投入及技术支持，IOT产品及音频产线境内外产品收入均持续增长；同时公司加强供应链管理，优化成本，毛利率同比上升，带来了毛利润增长，使得归属于母公司净利润及扣除非经常性损益的净利润均实现大幅增长。 |
| **上传日期** | 2024年11月12日 |